



SPRS TECHNOLOGIES

P/N:STBP165-2R4-A603

Thin Film Planar Filters

产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

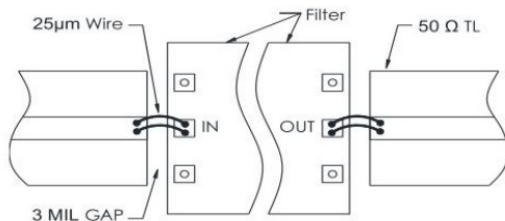
技术要求, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		16.5		GHz
工作频率	15.3		17.7	GHz
中心损耗		2.4	2.8	dB
带内波动		0.9	1.2	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制	@DC-13.8GHz	60	65	dBc
	@19.0-39.0GHz	60	65	dBc

环境要求

最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$	
储存温度	$-55^{\circ}\text{C}\sim+125^{\circ}\text{C}$	

推荐装配图



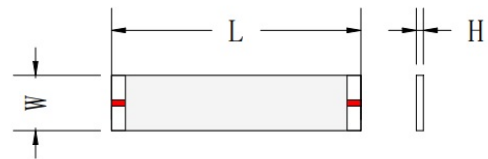
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**1.75mm**，芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 ($6.7\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$),载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配，T型尺寸如下:

电路板Rogers5880, h: 0.254mm	电路板Rogers5880, h: 0.127mm

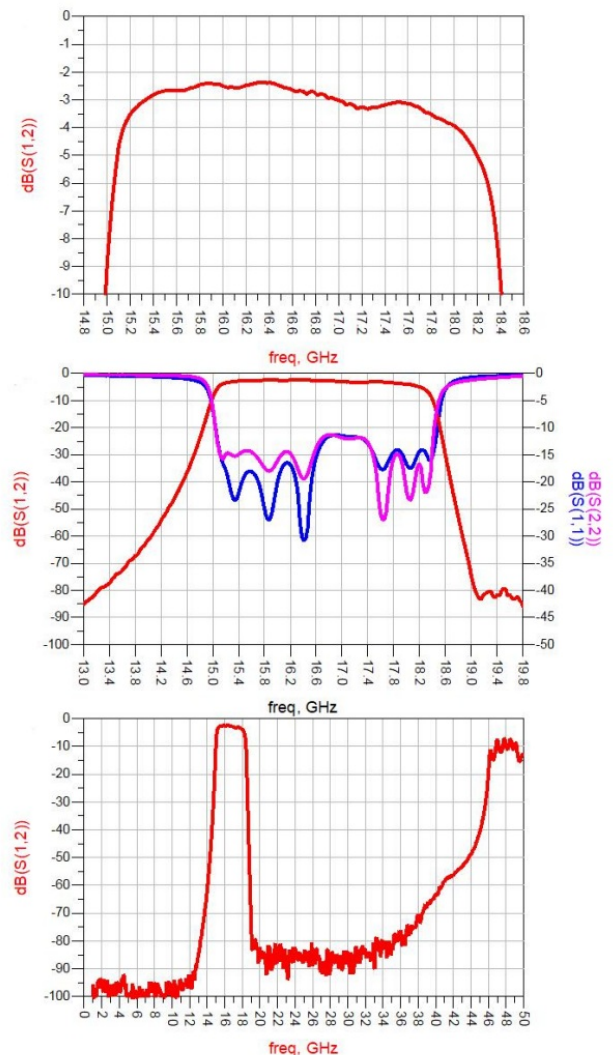
注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.5	2.5	0.254	mm

典型曲线, $T_A=25^{\circ}\text{C}$



注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。